

HASEGAWA



主力製品 精密マシニングセンタ
PM320-5XT

○本社所在地：埼玉県さいたま市見沼区
大和田町1-602

○事業概要：小型・高速・高精度な工作機械
（小型NC旋盤、小型マシニングセンタ、
複合機、自動化装置）の設計・製造・販売
中国子会社2社で現地製造・販売

○常時使用する従業員：140名
（グループ全体・2025年12月時点）

○現在の売上高：21億円
（グループ全体・2025年9月期）

○法人番号：9030001006910

○Web：http://www.hasegawa-m.co.jp/

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
長谷川 透

「大は小を兼ねない」 小型・高精度で世界のものづくりを支える

創業以来100年近く、「小物高精度部品の加工には小型機が適する」という信念のもと、
小型工作機械一筋で歩んでまいりました。医療・ロボット・航空機・光学・防衛の各分野で部品の高精度化が進み、
小型・高精度・高自動化の工作機械の役割は一段と大きくなっています。
白河工場への大型投資とグループ一体での海外展開により、2035年にグループ売上高100億円を実現します。
お客様の生産性向上と地域の雇用創出に貢献し、社員の成長と処遇改善を必ず果たします。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2025年の21億円を起点に、生産能力の増強と海外展開により、2030年45億円、2033年72億円、2035年100億円を達成する。
成長の源泉は、①白河工場の増築による生産能力の増強、②自動化・省人化商品の拡大、③海外市場（米国・中国・欧州・インド）の開拓、④半導体・医療・ロボット・航空機・光学・防衛の拡販。

課題

- ・人手に依存する工程の省人化と、熟練技能の標準化・デジタル化
- ・海外での完成品メーカーとしての認知度が低く、ブランド発信力が不足
- ・米国・中国・欧州・インドでの販売・サービス網とディーラーの開拓
- ・半導体・医療・ロボット・航空機・光学・防衛分野の比率引上げと複合機の拡充
- ・開発設計、生産技術、海外営業の人材の採用・育成と処遇改善

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- ・白河工場の増築（約1,980㎡）による組立・加工能力の増強
- ・最新マシニングセンタ、良好な温度環境での高精度研削ライン等への継続投資
- ・ロボット/ローダによる自動化・省人化仕様の標準商品化と無人化対応機種種の拡大
- ・海外展開の加速（米国・欧州・インド）と、中国子会社による現地生産・販売・開発の拡大
- ・半導体・医療・ロボット・航空機・光学・防衛向け複合機の開発とシェア拡大
- ・基幹システム刷新とDXによる原価・リードタイム管理の高度化、内製化率の向上

実施体制

- ・白河工場に設備投資・生産技術の専任体制を置き、増築と設備導入を一体推進
- ・中国は長机（上海）商貿（販売）と浙江長谷川机床（製造）が担い、本社と一体で運営
- ・その他の海外はエリア別担当制で、現地ディーラーと共同で販促・サービス教育
- ・地域のサプライヤーと連携し、設備資金は日本政策金融公庫とメインバンクから調達
- ・新卒の定期採用を継続し、社内教育と外部研修で技術・語学人材を育成

【フェーズ1】2026年～2028年 白河工場の増築と生産基盤の強化（グループ売上高21億円→33億円）

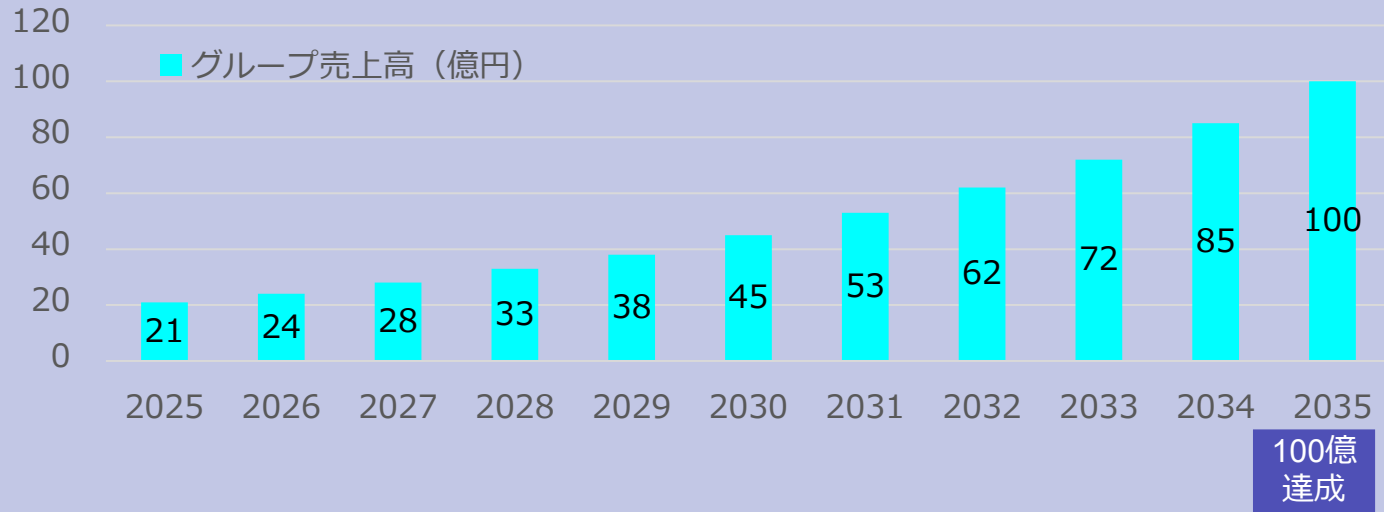
- ・白河工場の増築工事（約1,980㎡）に着手し、組立・加工能力を増強する。
- ・温度環境の良い工場に高精度加工ライン、最新マシニングセンタ等を導入し、内製化率と稼働率を高める。
- ・基幹システムの刷新とDXにより、原価管理とリードタイムの見える化・短縮を図る。

【フェーズ2】2029年～2032年 海外展開と新分野の開拓（グループ売上高38億円→62億円）

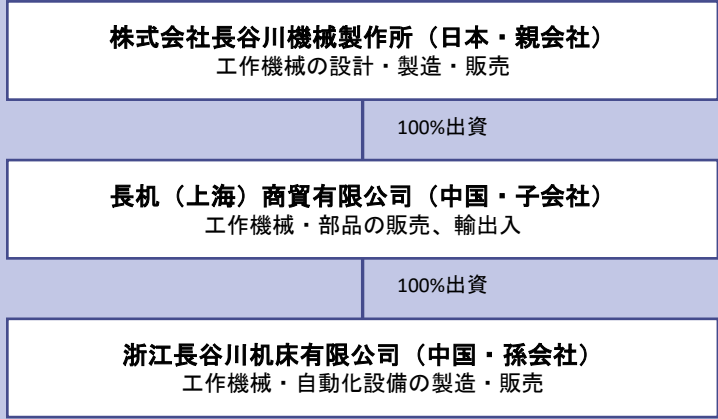
- ・中国は浙江の製造能力増強と上海の販売網拡充、米国・欧州・インドはディーラー網を整備する。
- ・半導体・医療・ロボット・航空機・光学・防衛向けの複合機を拡充し、高付加価値分野の比率を高める。
- ・ロボット／ローダによる自動化・省人化仕様を標準商品化し、無人運転対応を拡大する。

【フェーズ3】2033年～2035年 グループ売上高100億円の達成（72億円→100億円）

- ・増強した生産能力をフル稼働させ、国内外の販売・サービス網で受注を取り込む。
- ・開発設計、生産技術、海外営業の人材を継続採用し、処遇改善と技能伝承を定着させる。



■ グループ構成



■ 主な投資計画

- ・白河工場 増築工事：建築面積約1,980㎡
- ・生産・組立設備：マシニングセンタ、研削盤、測定機等の増設・更新
- ・開発設備：試作・評価設備の整備
- ・DX・基幹システム：生産管理／原価管理システムの刷新
- ・人材投資：開発設計・生産技術・海外営業の採用育成と処遇改善

■ 重点市場

- ・地域：中国（子会社2社）、米国、欧州、インド
- ・分野：半導体、医療、ロボット、航空機、光学、防衛（高付加価値分野の比率向上）